

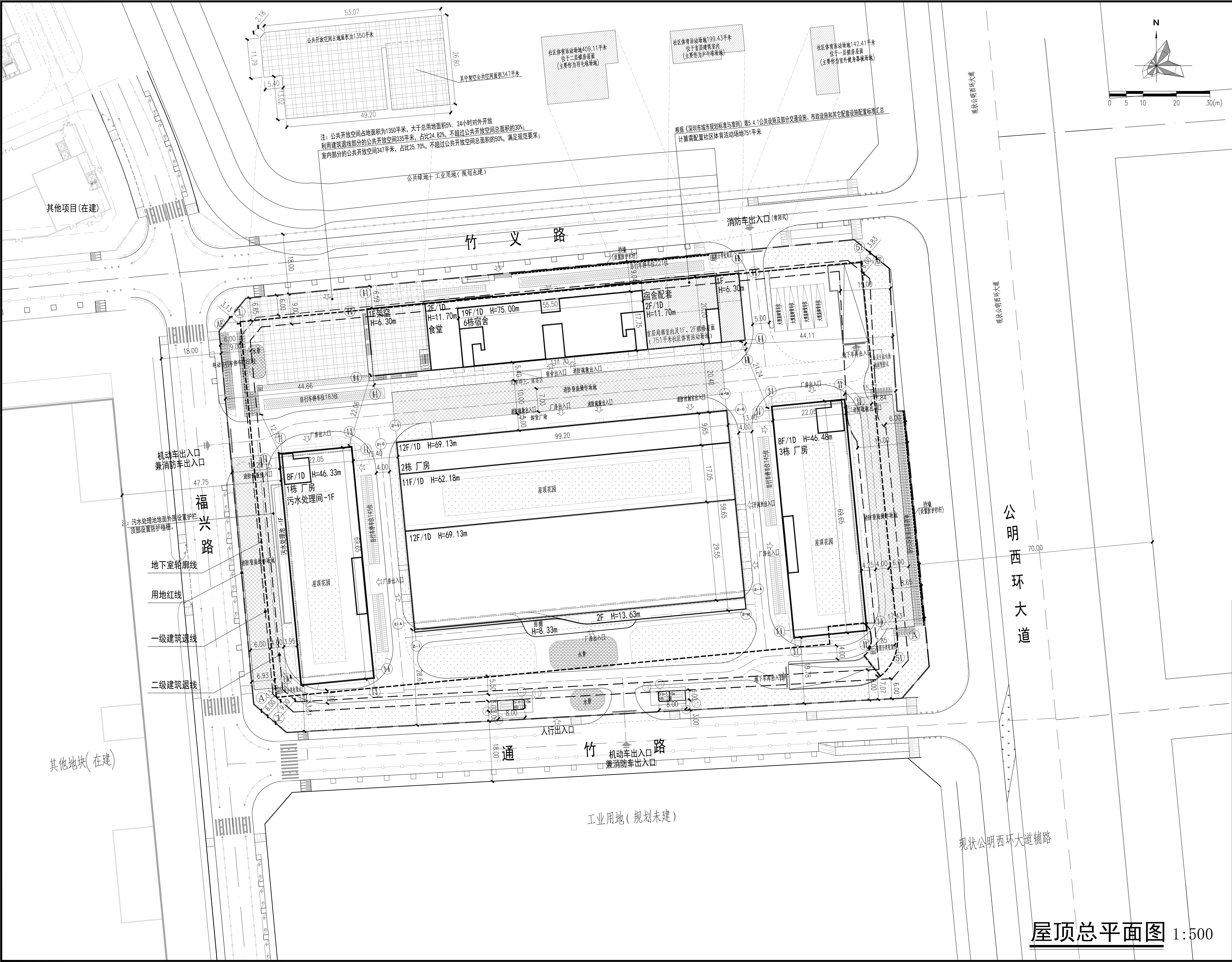


图 例	
1	用地红线
2	一级建筑退线
3	二级建筑退线
4	新建建筑
5	车行/人行出入口
6	新建道路
7	铺装材料/电动材料
8	绿化范围
9	景观水系
10	公共开放空间
11	社区体育活动场地
12	消防登高操作场地
13	货车停车位
14	减速带

注：地面配备4个大置装卸车停车位。

- 说明
- 设计依据：
 - 1.1 深圳市规划和自然资源局光明管理局批复的宗地附图(宗地号A624-0230);
 - 1.2 深圳市规划和自然资源局光明管理局2026.04.10批复的建设用地规划许可证(地字第4403112026YG0029613)及规划设计要点批复表(CM202600109);
 - 1.3 业主提供的任务书、文件及相关要求、说明及周知市政资料。
 - 1.4 现行国家有关设计规范、规定、通则以及广东省和深圳市颁布的建筑设计规范、规定。
 - 图中坐标和标高与用地红线坐标系(2000国家大地坐标系)和地形图高程系统(1985国家高程基准)一致。
 - 图中建筑脚平面为建筑物的屋顶外轮廓平面,地下室轮廓为地下室平面外轮廓线。
 - 建筑定位坐标为轴线交点坐标。
 - 图中标注的尺寸均为建筑物外墙之间、建筑物与相邻构筑物之间、道路边线之间、或建筑脚用地红线的距离。
 - 图中所注建筑高度H为室外地面至建筑屋顶完成面高度。
 - 道路开口最终以规划部门批复的工程规划许可(路口)为准。
 - 图中绿化、广场、室外台阶及装饰、挂墙等详景观二次设计。
 - 本项目配建1350平方米的公共开放空间,24小时无条件对所有市民开放。
 - 图中尺寸、坐标和标高均以米为单位。

一、项目概况									
项目名称		关键电子元器件产业园建设工程		用地单位	深圳江浩电子有限公司				
宗地号		A624-0230		用地位置	马田街道通竹路和公明西环大道交汇处西北侧				
二、主要经济技术指标									
总用地面积		建设用地面积	26853.57	㎡	总建筑面积	130772	㎡		
26853.57		㎡	道路用地面积	-	㎡	计规定容积率建筑面积	107811(108654)	㎡	
容积率/规定容积率		4.09/4.02		㎡	容积率建筑面积	109717	㎡		
地上规定建筑面积		107811		㎡	不计容积率建筑面积	21055	㎡		
地下核增建筑面积		21055		㎡	地上核增建筑面积	1906	㎡		
地下核减建筑面积		-		㎡	地上核减建筑面积	-	㎡		
绿化覆盖率		19/1		层	建筑覆盖率（一级/二级）	38.89%/34.59%			
建筑最高高度		75.00		m	建筑基底面积	10443	㎡		
绿地面积/折算绿地面积		20.50%		㎡	机动车停车位（地上/下）	399(10/389)			
社区体育活动场地		2617.54/2887.46		㎡	其中充电桩车位（地上/地下）	120(0/120)			
公共开放空间		751		㎡	自行车停车位（地上/下）	870/0			
		1350		㎡	其中充电自行车停车位（地上/地下）	176/0			
三、本期建筑面积分配									
总建筑面积㎡ 130772㎡		计容积率建筑面积 109717㎡	地上	建筑功能	规定	核减	合计		
				厂房	89796	-	89796		
				食堂	2199	-	2199		
		不计容积率建筑面积 21055㎡	地下	宿舍	15816	-	15816		
				地上核增建筑面积	社区体育活动场地专用交通空间				105
				1906㎡	架空绿化休闲				1390
				屋面楼梯电梯间及机房		411			
				共用停车库		16765			
				公用设备用房		4290			
四、地上建筑分栋指标面积及分配									
栋号	高度(M)	层数(F)	规定功能	规定面积（㎡）	核增功能	核增面积（㎡）			
1栋	46.33	8	厂房	12227	屋面楼梯电梯间及机房	123			
2栋	69.13	12	厂房	65322	-	-			
3栋	46.48	8	厂房	12227	屋面楼梯电梯间及机房	123			
4栋	5.10	1	门卫	10	-	-			
5栋	5.10	1	门卫	10	-	-			
6栋	75.00	19	宿舍/食堂	18015	社区体育活动场地 专用交通空间	105			
				架空绿化休闲				1390	
				屋面楼梯电梯间及机房				165	

会签栏

总图	电气
建筑	给排水
结构	暖通

说明

1.设计依据：
1.1 深圳市规划和自然资源局光明管理局批复的宗地附图(宗地号A624-0230);
1.2 深圳市规划和自然资源局光明管理局2026.04.10批复的建设用地规划许可证(地字第4403112026YG0029613)及规划设计要点批复表(CM202600109);
1.3 业主提供的任务书、文件及相关要求、说明及周知市政资料。
1.4 现行国家有关设计规范、规定、通则以及广东省和深圳市颁布的建筑设计规范、规定。
2. 图中坐标和标高与用地红线坐标系(2000国家大地坐标系)和地形图高程系统(1985国家高程基准)一致。
3. 图中建筑脚平面为建筑物的屋顶外轮廓平面,地下室轮廓为地下室平面外轮廓线。
4. 建筑定位坐标为轴线交点坐标。
5. 图中标注的尺寸均为建筑物外墙之间、建筑物与相邻构筑物之间、道路边线之间、或建筑脚用地红线的距离。
6. 图中所注建筑高度H为室外地面至建筑屋顶完成面高度。
7. 道路开口最终以规划部门批复的工程规划许可(路口)为准。
8. 图中绿化、广场、室外台阶及装饰、挂墙等详景观二次设计。
9. 本项目配建1350平方米的公共开放空间,24小时无条件对所有市民开放。
10. 图中尺寸、坐标和标高均以米为单位。

设计专用章

本图未加盖设计专用章无效
注册执业章

万禹工程设计有限公司

建筑行业(建筑工程)甲级
风景园林工程设计专项乙级
市政行业给水、排水、道路、桥梁工程乙级
城乡规划编制乙级

职 责	姓 名	签 署
项目负责	洪卫军	
专业负责	洪卫军	
审 定	谢建华	
审 核	洪卫军	
校 对	陆功	
设 计	冷进伟	

建设单位 深圳江浩电子有限公司

项目名称 关键电子元器件产业园建设工程

子项名称 总图

图 名 屋顶总平面图

日期 202608 设计号 WY20262023

设计阶段 方案图

版 次 第一版

专 业 建筑

图 号 建方-Z-01

屋顶总平面图 1:500